Stack up & impedance

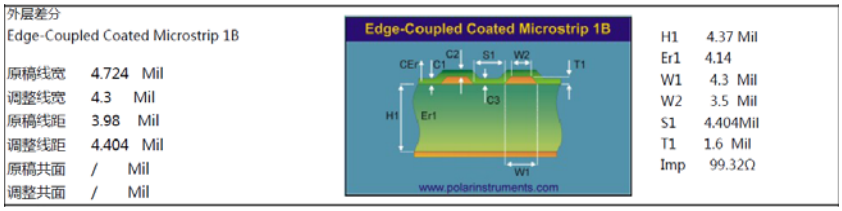
一、参数描述（Parameter description）：

文件名 File Name：	PCB_EVK75123-MLX75024 V1.1 Q18C-0103 (S034879C8A)					层数： Layers	8			成品板厚（mm）： Finished thickness	1.2±10%	
设计参数(Designed para.)	层次 Layer	属性 Attri.	线宽 W (MIL)	线距 S (MIL)	铜厚 Copper （OZ）	要求值 Required (OHM)	参考层 Ref.	推荐参数(Recommended para.)	线宽 W (MIL)	线距 S (MIL)	铜厚 Copper （OZ）	理论阻抗值 Theory (OHM)	图示 Fig.
	TL/BL	Diff	4.724	6.98	1	100	L2/L3		4.3	4.4	1	100 ±10%	P1
	L3	Diff	4.724	6.98	1	100	L2&L4		3.3	5.4	1	100 ±10%	P2

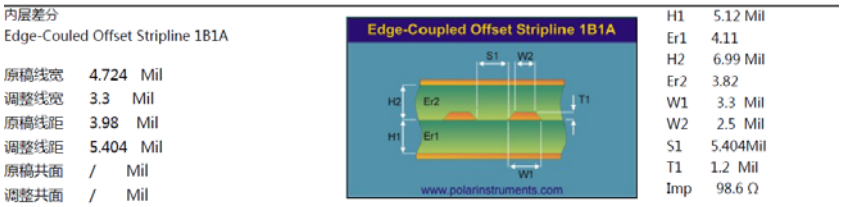
二、阻抗模拟计算示意图(图片不清晰时请 CTRL+鼠标中键放大)：

Simulation impedance (Use CTRL+Middle key to enlarge the pictures):

P1：



P2：



三、推荐结构：

Recommended structures：

TL ---------- 0.5oz+Plating

2116*1 4.8MIL

L2 1oz

FR4 0.13mm 不含铜

L3 1oz

1080*2 5.5MIL

L4 1oz

FR4 0.1MM 不含铜

L5 1oz

1080*2 5.5MIL

L4 1oz

FR4 0.13MM 不含铜

L5 1oz

2116*1 4.8MIL

BL ---------- 0.5oz+Plating

压合板厚(Pressed thickness)：1.1±0.1mm

完成板厚：1.2mm+/-10%

四、客户确认 (**Customer Reply**)：　　签名(**Signature**)：

制表(**Lister**)：　　审核(**Checker**)：

备注：我司将严格按照客户确认的参数和结构生产加工，对影响阻抗的线宽、线距、铜箔厚度和介质厚度的控制负责；影响阻抗的因素是多方面的，敬请客户充分考虑资料的线路设计、电地布局及元器件匹配等因素。

Notes: The PCB will be produced by the parameters and structures which customer confirmed, we will highly control the different factors such as width, spacing, copper thickness and dielectric thickness. We hope that customer should be fully considered the pcb design because the factors that affected impedance are many-sided.